基于 DEFORM 三维多晶体 材料微结构的有限元分析

何凤兰,李旭东,王国梁

(兰州理工大学 甘肃省有色金属新材料省部共建国家重点实验室,甘肃 兰州 730050)

摘 要:利用本课题组自主开发的计算机软件 AutoRVE,实现三维多晶体材料微结构的几何建模,网格划分,并将生成的 Input 的文件通过脚本语言 Python 的编译,实现在 DEFORM 中建立三维多晶体微结构的具体材料模型,并进行挤压过程热力耦合仿真分析,演示出了三维多晶体材料微结构的温度场及等效应力、等效应变分布结果。

关键词:三维多晶体;材料微结构;Key 文件;Input 文件中图分类号:TG14

1 DEFORM 简介

DEFORM - 3D 是一套基于工艺模拟系统的有限元系统(FEM),专门设计用于分析各种金属成形过程中的三维(3D)流动,提供极有价值的工艺分析数据,及有关成形过程中的材料和温度流动。主要包括前处理器、模拟器、后处理器三大模块。前处理器处理模具和坯料的材料信息及几何信息的输入、成形条件的输入,建立边界条件,它还包括有限元网格自动生成器;模拟器是集弹性、弹塑性、刚(粘)塑性、热传导于一体的有限元求解器;后处理器是将模拟结果可视化,支持OpenGL图形模式,并输出用户所需的模拟数据。DEFORM允许用户对其数据库进行操作,对系统设置进行修改,以及定义自己的材料模型等[1],如图1所示。

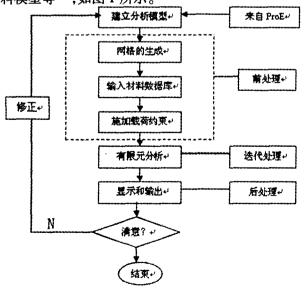


图 1 有限元分析流程图

2 DEFORM 前处理程序的二次开发

2.1 材料代表性体积单元(RVE)

材料微结构细观力学响应的数值计算建立在材 料微观组织结构的"代表性体积单元"(RVE)技术 上。微观组织结构的"代表性体积单元"定义在材 料的细观尺度上。"代表性体积单元"其体积尺寸 是最小的、但体积单元内却包含了足够多微观组织 结构组成物的几何信息、晶体学取向信息、分布信息 与相场信息,并能在统计学意义上(统计平均性质) 代表材料微观组织结构的基本特征,由"代表性体 积单元"组成的材料称为统计均匀材料,统计均匀 材料受到均匀边界条件的作用,则介质内的场变量 是统计均匀场。值得指出的是,应该根据材料实际 (或模拟)的微观组织结构组成物的几何构造、取向 分布与结构,计算材料微观组织结构的"代表性体 积单元"内的细观力学响应以及材料性能。"代表 性体积单元"的细观应力的体积平均响应程度必须 与"代表性体积单元"边界上所承受的外加载荷程 度相一致[2-6]。

2.2 几何模型的建立

挤压件原始尺寸为: 1000mm × 1000mm × 500mm(长度×宽度×厚度),其开始温度为900℃,上下模具温度都为300℃。材料假定是各相同性的,挤压件和上下模之间采用剪切摩擦模型,摩擦系数是0.3。工件的自由表面与周围环境之间的等效换热系数取为180.2N/(s·m²·c),工件与上下模之间的接触传热系数取为5N/(s·m²·c),辐射率为0.7。坐标系的建立为: Z 轴的负方向为挤压方向。

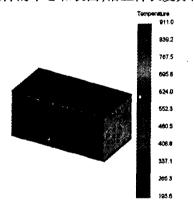
2.3 多晶体材料微结构的数据准备

利用本课题组自主开发的计算机软件 AutoRVE,即可在 ABAQUS 有限元软件中,建立材料微结构的"代表性体积单元"(RVE)的几何模型,并根据几何模型画出有限元计算网格,单元体数目:199738,结点:36000,总模拟步数为100,模拟时间步长为:0.01s。由于 DEFORM 对工件赋予不同材料属性的限制,在编译的过程中,设置6种材料属性。实现对所有的单元赋材料属性,具体是将同一晶粒对应的多个单元赋予同一材料属性。而后利用C语言编译生成6种新材料,为了使整个工件的材料属性差别不易过大,在编译材料属性时仅对材料的杨氏模量进行少量的增加,分别命名为 NEW - I(I=1-6)。这样即可将每个晶粒可视化显现出来。图2显示了含有1000个晶粒的三维多晶体网格划分材料微结构(挤压件模型)。

3 三维多晶体材料微结构模拟结果及分析

3.1 温度场分布

为更好地反映整个挤压过程中工件各部位温度的变化规律,在工件的中心和表面,沿工件长度方向



(a)第50步温度分布

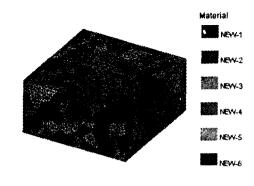
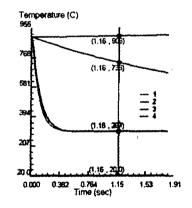


图 2 三维多晶体网格划分材料微结构(挤压工件模型)

提取截面上的关键点进行温度跟踪分析,将各点的温度随时间变化作曲线,演示了含有1000个晶粒的多晶体材料挤压过程中温度分布,如图3所示。P1为多晶体材料商标名的中心点,P2为多晶体材料的内部中心点,P3为上表面的侧面中点,P4为侧面的中心点。结果表明,工件各部位关键点的温度随挤压过程时间的增加均呈现下降的趋势,特别是工件表面中心节点P1,及工件边部节点P3在挤压过程中,与上模具产生接触温度曲线起伏显著,温度急剧下降;工件在与空气的热交换过程中温度变化缓慢,P4的温降变化不太明显。中心处节点P2温度略有提升(这是因为塑性功转化为热的结果)。



(b) 节点温度随时间变化分布

图 3 多晶体材料挤压过程温度场分布

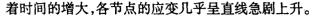
3.2 应力分析

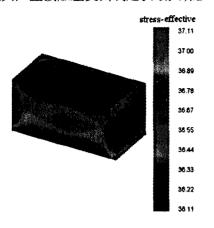
通过对关键点等效应力变化进行跟踪,图 4 演示了含有 1000 个晶粒的三维多晶体材料微结构模型算例及其等效应力分析结果。当工件开始与上下模接触时,如图 4(a) 所示,挤压变形内部中心区节点 P2 的应力最大,工件边部节点 P3 在挤压过程中与上模具产生接触应力曲线起伏不大,如图 4(b) 为等效应力随计算时间的变化曲线。各节点的应力急剧上升,而后在达到稳定状态呈缓慢增长趋势,在整个挤压过程中,节点 P1 应力曲线起伏相当大。

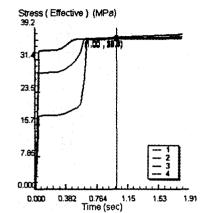
3.3 应变分析

通过对关键点等效应变变化进行跟踪,图 5 演示了含有 1000 个晶粒的三维多晶体材料微结构模型算例及其等效应变分析结果。如图 5(a)所示,在整个挤压过程中,在工件边部及挤压变形内部中心区呈现出较大的等效应变,表面中心处和侧面处应变相对较小。图 5(b)为等效应变随计算时间的变化曲线,可以看出:关键点等效应变首先增长缓慢几乎趋近于零,在工件挤压后塑性变形逐渐增大,等效塑性应变也随之增大。在整个挤压过程中,工件边

部节点 P3 与上模具产生接触应变曲线起伏最大,随



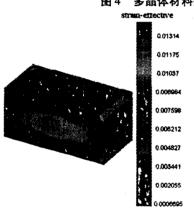


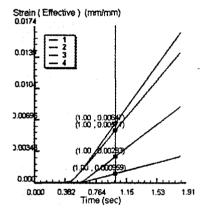


(a)第50步等效应力分布

(b) 节点等效应力随时间变化图

图 4 多晶体材料挤压过程等效应力分析





(a)第50步应变分布

(b)节点等效应变随时间变化图

图 5 多晶体材料挤压过程等效应变分析

4 结论

采用商业有限元软件 DEFROM 对多晶体材料进行了挤压过程模拟分析,模拟结果表明:

- (1)通过脚本语言 Python 的编译,对外部数据 Input 文件提取 Key 文件所需要的有效数据,进而对已产生的 Key 文件进行替换及添加,实现在 DE-FORM 中建立三维多晶体微结构的具体材料模型,完成该细观模型的建立。
- (2)对 DEFORM 3D 进行前处理二次开发,导入多晶体材料的微结构模型,并进行挤压过程热力耦合仿真分析。得到了三维多晶体材料微结构的温度场及等效应力、等效应变分布结果。
- (3)用户可以返回 DEFORM 中通过 GUI 环境下的操作实现某些用户自定义的特性,如,具体的某种材料、具体所需的分析步、具体的边界条件与加载方式,或者通过更改模型的 Key 文件实现对模型的用户自定义,再对模型进行分析。

参考文献:

- [1] 周朝辉,曹海桥,吉卫,等. DEFO RM 有限元分析系统软件及其应用[J].2003(4):51-52.
- [2] 龙弟德,李旭东,余斌,等. ABAQUS 前处理程序二次 开发在多晶体材料微结构建模中的应用[J]. 甘肃科 技,2008,24(6):91-93.
- [3] 李俊琛,李旭东,刘德学. 空间点集 Voronoi 图的海量构造算法及可视化技术[J]. 兰州理工大学学报, 2008,33(5):99-104.
- [4] 任淮辉,李旭东,李俊琛.三维多晶体材料微结构的 力学响应计算[J]. 兰州理工大学学报,2008,34(1):1 -5.
- [5] 任淮辉,李旭东,刘德学,等.三维复合材料微结构的 力学响应分析[J].兰州理工大学学报,2008,34(2):1 -5.
- [6] LI Xudong. An innovative concept and novel microstructure related parameter material structure weakness [J]. Material Science and Engineering A, 2004, 386(1):415-419.